

マイクロ接合功績賞

受賞年		受賞日	受賞者	所属
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	片山茂	元 日本電気(株)
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	仲田周次	大阪大学
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	田中政直	元 石福金属工業(株)
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	日置進	元 (株)日立製作所
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	宮里孝典	元 精工舎
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	青野進	元 日本アビオニクス(株)
1997年度	平成9年度	H10年4月17日	牧野光男	(株)東芝
1997年度	平成9年度	H10年4月17日	島田彌	三菱電機(株)
1997年度	平成9年度	H10年4月17日	関泰知	(株)ニコン
1997年度	平成9年度	H10年4月17日	横井和雄	富士通(株)
1998年度	平成10年度	H11年5月14日	窪田正	松下冷機(株)
1999年度	平成11年度		該当者なし	
2000年度	平成12年度	H13年5月25日	野津誠	元 松下電子工業(株)
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	池田順治	元 松下電器産業(株)
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	竹本正	大阪大学
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	河野英一	元 日本電気(株)
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	佐藤英紀	元 日本アビオニクス(株)
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	清水俊夫	セイコープレシジョン(株)
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	町田一道	元 三菱電機(株)
2002年度	平成14年度		該当者なし	
2003年度	平成15年度	H16年5月14日	渥美幸一郎	(株)東芝
2003年度	平成15年度	H16年5月14日	河野顕臣	(株)日立製作所
2003年度	平成15年度	H16年5月14日	齊藤亨	日鐵テクノリサーチ(株)
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	田井英男	帝京大学 理工学部
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	瀬尾健二	兵庫県立大学 大学院
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	齋藤重正	富士電機機器制御 (株)
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	松村慶一	富士エクサス (株)
2005年度	平成17年度	H18年5月26日	高橋康夫	大阪大学
2005年度	平成17年度	H18年5月26日	岩見基弘	元 岡山大学
2006年度	平成18年度		該当者なし	
2007年度	平成19年度		該当者なし	
2008年度	平成20年度		該当者なし	
2009年度	平成21年度		該当者なし	
2010年度	平成22年度	H23年5月27日	佐藤武彦	大阪大学
2010年度	平成22年度	H23年5月27日	芹沢弘二	(株)日立製作所
2010年度	平成22年度	H23年5月27日	武井利泰	日本精工(株)

マイクロ接合功績賞

受賞年		受賞日	受賞者	所属
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	藤本公三	大阪大学
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	加柴良裕	三菱電機(株)
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	荘司郁夫	群馬大学
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	廣瀬明夫	大阪大学
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	森郁夫	(株)東芝
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	岩田剛治	大阪大学
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	佐藤了平	大阪大学
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	出田吾朗	三菱電機(株)
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	加藤力弥	千住金属工業(株)
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	弘田実保	(株)村田製作所
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	大熊秀雄	(有)H T O
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	荘司孝志	元 昭和電工(株)
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	気賀智也	元 ソニーEMCS(株)
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	鎌田信雄	化研テック(株)
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	阪元智朗	オムロン(株)
2012年度	平成24年度		該当者なし	
2013年度	平成25年度		該当者なし	
2014年度	平成26年度		該当者なし	
2015年度	平成27年度		該当者なし	
2016年度	平成28年度		該当者なし	
2017年度	平成29年度		該当者なし	
2018年度	平成30年度		該当者なし	
2019年度	令和元年度		該当者なし	
2020年度	令和2年度		該当者なし	
2021年度	令和3年度		該当者なし	
2022年度	令和 4 年度	R5年5月12日	岩本知広	茨城大学
2022年度	令和 4 年度	R5年5月12日	柴崎正訓	(株)タムラ製作所
2023年度	令和5年度		該当者なし	
2024年度	令和6年度	R7年5月23日	松坂壮太	千葉大学

マイクロ接合研究賞

受賞年		受賞日	受賞者	所属	受賞講演
1995年度	平成7年度	H8年7月24日	田中靖久	大豊工業(株)	耐疲労性を向上させたはんだ合金の開発
1995年度	平成7年度	H8年7月24日	塚田敏彦	(株)豊田中央研究所	メニスコグラフ法における接触角測定技術の開発（2）－接触角計測システム－
1995年度	平成7年度	H8年7月24日	富岡泰造	(株)東芝	レーザーシングルポイント I L B 技術
1995年度	平成7年度	H8年7月24日	村田敏一	松下電器産業(株)	Pbフリーソルダの使用性能と問題点
1995年度	平成7年度	H8年7月24日	巽宏平	新日本製鐵(株)	狭ピッチボールボンディングにおけるAu-Al接合信頼性
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	荘司郁夫	日本アイ・ビー・エム(株)	ワイヤボンド用チップを用いた狭ピッチフリップチップアタッチ実装法
1996年度	平成8年度	H9年5月28日	森山正人	(株)本田技術研究所	電装部品におけるハンダ接合の信頼性
1997年度	平成9年度	H10年4月17日	荏谷義治	芝浦工業大学	Sn-3.5mass%Ag-X系合金ソルダの疲労特性に関する研究
1997年度	平成9年度	H10年4月17日	元山有子	(株)富士通研究所	異方導電性接着剤を用いた素子接合の接合安定性
1998年度	平成10年度	H11年5月14日	田中直敬	(株)日立製作所	吸湿による樹脂膨潤を考慮した I C パッケージ接着界面のはく離発生評価
1998年度	平成10年度	H11年5月14日	落合正行	(株)富士通研究所	ディンプルプレート法による微細バンプの形成
1999年度	平成11年度	H12年5月26日	下戸直典	日本電気(株)	超多ピン半導体パッケージ用実装基板
1999年度	平成11年度	H12年5月26日	米田義之	富士通(株)	Super CSP の開発
1999年度	平成11年度	H12年5月26日	後藤友彰	富士電機(株)	シリコンとセラミックスの陽極接合技術
2000年度	平成12年度	H13年5月25日	山中浩	松下電工(株)	M I D 技術による射出成形立体回路を応用した微小オプトデバイスの開発
2000年度	平成12年度	H13年5月25日	成田敏男	北海道大学	Sn-Ag-Cuソルダの組織に対する組成と冷却速度の影響
2000年度	平成12年度	H13年5月25日	鳥越俊宏	日本電気(株)	レーザ C V D 技術と液晶表示装置への応用
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	山根常幸	(株)東レリサーチセンター	接合界面の熱伝導現象解析
2001年度	平成13年度	H14年5月23日	赤池信一	タムラ化研(株)	鉛フリー対応水溶性耐熱ブリフลักス
2002年度	平成14年度	H15年5月23日	八木能彦	松下電器産業(株)	SBB方式フリップチップ実装における導電性接着剤接合技術
2002年度	平成14年度	H15年5月23日	秋山雪治	技術研究組合 超先端電子技術開発機構	20 μ m ビッチ微細バンプ超音波接合技術
2003年度	平成15年度	H16年5月14日	宮崎誠	長野沖電気(株)	Sn-Ag-Cu鉛フリーはんだにおけるフローはんだ付け特性に及ぼす不純物の影響
2003年度	平成15年度	H16年5月14日	藤原伸一	(株)日立製作所	Auバンプを用いた接触接続の信頼性設計技術
2003年度	平成15年度	H16年5月14日	菅謙太郎	(株)東芝	CdTe素子を用いた γ 線検出器モジュールの開発
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	吉野睦	(株)デンソー	ボンディングワイヤーのゲル中における共振のメカニズム解明と信頼性確保に関する研究
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	今泉延弘	(株)富士通研究所	ハイエンドCMOSチップ向けアンダーフィル技術
2004年度	平成16年度	H17年5月27日	三代絹子	富士通（株）	BGAはんだ接合部のボイドが信頼性に及ぼす影響
2005年度	平成17年度	H18年5月26日	竹澤由高	(株)日立製作所	ナノ構造制御エポキシ絶縁樹脂
2005年度	平成17年度	H18年5月26日	馬場陽一郎	トヨタ自動車(株)	H V インバーター品質確保の取り組み
2005年度	平成17年度	H18年5月26日	山部光治	(株)東芝	Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだの熱疲労寿命予測式の構築と低・中融点Pbフリーはんだの寿命比較
2006年度	平成18年度	H19年5月25日	粥川君治	(株)デンソー	パワーデバイス裏面電極と鉛フリーはんだの界面構造と接合性
2006年度	平成18年度	H19年5月25日	守田俊章	(株)日立製作所	半導体パッケージのはんだボール接合部に対する衝撃強度評価方法
2007年度	平成19年度	H20年5月30日	前田晃	三菱電機(株)	Sn-Ag-Cuはんだ中Au含有量が信頼性に与える影響
2007年度	平成19年度	H20年5月30日	青木雄一	エスベック(株)	はんだ接合部の熱疲労試験に及ぼす温度変化率の影響
2007年度	平成19年度	H20年5月30日	佐藤敦哉	NECシステム実装研究所	異方性導電ゴムコネクタを用いた多段積層接続技術の開発
2008年度	平成20年度	H21年6月5日	坂本善次	(株)デンソー	両面放熱パワーモジュールの実装技術
2008年度	平成20年度	H21年6月5日	林真太郎	パナソニック電工(株)	MEMSチップ実装における応力緩和構造の研究
2009年度	平成20年度	H21年6月5日	鶴田加一	千住金属工業(株)	Precoat by Powder Sheet(PPS)法による微小はんだブリコート形成技術
2009年度	平成21年度	H22年6月11日	獅子原祐樹	大阪大学	温度サイクル負荷による材料特性変化がはんだ接合部の疲労特性に及ぼす影響
2010年度	平成22年度	H23年5月27日	作山誠樹	(株)富士通研究所	低環境負荷プロセスの実現に向けた低温接合技術の開発
2010年度	平成22年度	H23年5月27日	江阪久雄	防衛大学校	Sn-Ag-Cu三元系鉛フリーはんだの凝固過程の解析
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	佐々木陽光	(株)東芝	銀ナノ粒子を用いた高信頼性ダイボンド技術
2011年度	平成23年度	H24年5月15日	三橋和成	(株)東レリサーチセンター	太陽電池モジュールの高分子部材の構造評価
2012年度	平成24年度	H25年5月24日	斎藤彰	(株)村田製作所	熱衝撃Snウィスカの成長に及ぼす板状のNi-Sn金属間化合物の影響
2012年度	平成24年度	H25年5月24日	澄川貴志	京都大学	超微小試験片の作製と力学実験
2013年度	平成25年度	H26年7月4日	島津武仁	東北大学	原子拡散接合法によるウエハの室温接合技術の現状と課題
2013年度	平成25年度	H26年7月4日	東平知丈	(株)日立製作所	高温対応熱電変換素子の接合技術
2014年度	平成26年度	H27年6月5日	岩本知広	茨城大学	超音波端子接合における界面現象
2015年度	平成27年度	H28年5月20日	畠山友行	富山県立大学	熱・電気連成解析を用いたパワーSi MOSFET内部の温度分布予測
2016年度	平成28年度	H29年5月26日	八甫谷明彦	(株)東芝ストレージ&デバイス ソリューション社	半導体モジュール技術と分子接合技術

マイクロ接合研究賞

受賞年		受賞日	受賞者	所属	受賞講演
2017年度	平成29年度	H30年7月27日	中崎義晃	(株)ナノ・キューブ・ジャパン	ナノ銅を用いたパワーデバイス向け新規導電材料
2017年度	平成29年度	H30年7月27日	谷澤秀和	サンケン電気(株)	SiC高温動作に向けたモジュール開発
2018年度	平成30年度	R1年5月31日	伊藤宏文	(株)豊田中央研究所	半導体チップとCu基板のダイボンド構造における接合材が冷熱サイクル信頼性に及ぼす影響
2018年度	平成30年度	R1年5月31日	松田朋己	大阪大学	酸化物還元反応を用いた窒化アルミニウムと金属の直接接合プロセス
2019年度	令和元年度	R2年7月29日	藤原英道	古河電気工業(株)	銅ナノペーストの活性焼結メカニズムとその応用について
2020年度	令和2年度	R3年6月18日	井上雅博	群馬大学	導電性接着剤におけるフィラー／バインダ界面の化学的相互作用と電気伝導特性発達の関係
2021年度	令和3年度	R4年7月29日	松坂壮太	千葉大学	固体イオン交換法によるガラス内金属析出物の形成とその応用
2022年度	令和４年度	R5年5月12日	佐々木朋裕	新潟大学	Al合金の超音波ろう付における接合部の形成過程
2023年度	令和5年度	R6年5月24日	小濱和之	地方独立行政法人京都市産業技術研究所	接合後に高融点化する Si 基フィラーの材料設計とセラミックス高耐熱接合への応用
2023年度	令和5年度	R6年5月24日	岸本貴臣	田中貴金属工業(株)	パワーデバイスにおける接合材料の開発動向
2024年度	令和6年度	R7年5月23日	依田智子	(株)日立製作所	長期保存電子部品のはんだ濡れ性改善に関するギ酸処理再生技術
2024年度	令和6年度	R7年5月23日	佐藤雄二	大阪大学	高輝度青色半導体レーザを用いた銅皮膜形成技術の開発